



MK Electron Co., Ltd.

INVESTOR RELATIONS

2021. 3.

DISCLAIMER

- 본 자료는 투자자에게 엠케이전자(주)(이하 회사)의 영업전망, 경영목표, 사업전략 등 정보제공을 목적으로 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.
- 본 자료에 포함된 예측정보는 과거가 아닌 미래의 사건에 관계된 사항이며 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는바, 회사가 통제할 수 없는 시장환경의 변동 및 위험 등의 불확실성으로 인해 회사의 실제 영업실적 결과와 일치하지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
- 마지막으로 본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것이며, 당사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다

1

MK Electron Co., Ltd.

Company Overview

대표이사	이진
설립일	1982년 12월 16일
주요사업	본딩와이어, 솔더볼, 증착재(Target, EVM) Solder Paste, Tape, 주식재생
자본금	109억원(총 주식 수 : 21,807,689주)
임직원수 (2020년 12월 기준)	289명
매출액 (2019년 연결 기준)	7,316억
사업장	국내 - 용인(본사), 음성, 시흥, 안산 해외 법인 - 쿤산(중국) 해외 지사 - 신주(대만)



설립기

- 1982 법인 설립(미경사)
- 1983 골드 와이어 특허취득
- 1986 용인공장 준공 및 연구소 설립

도약기

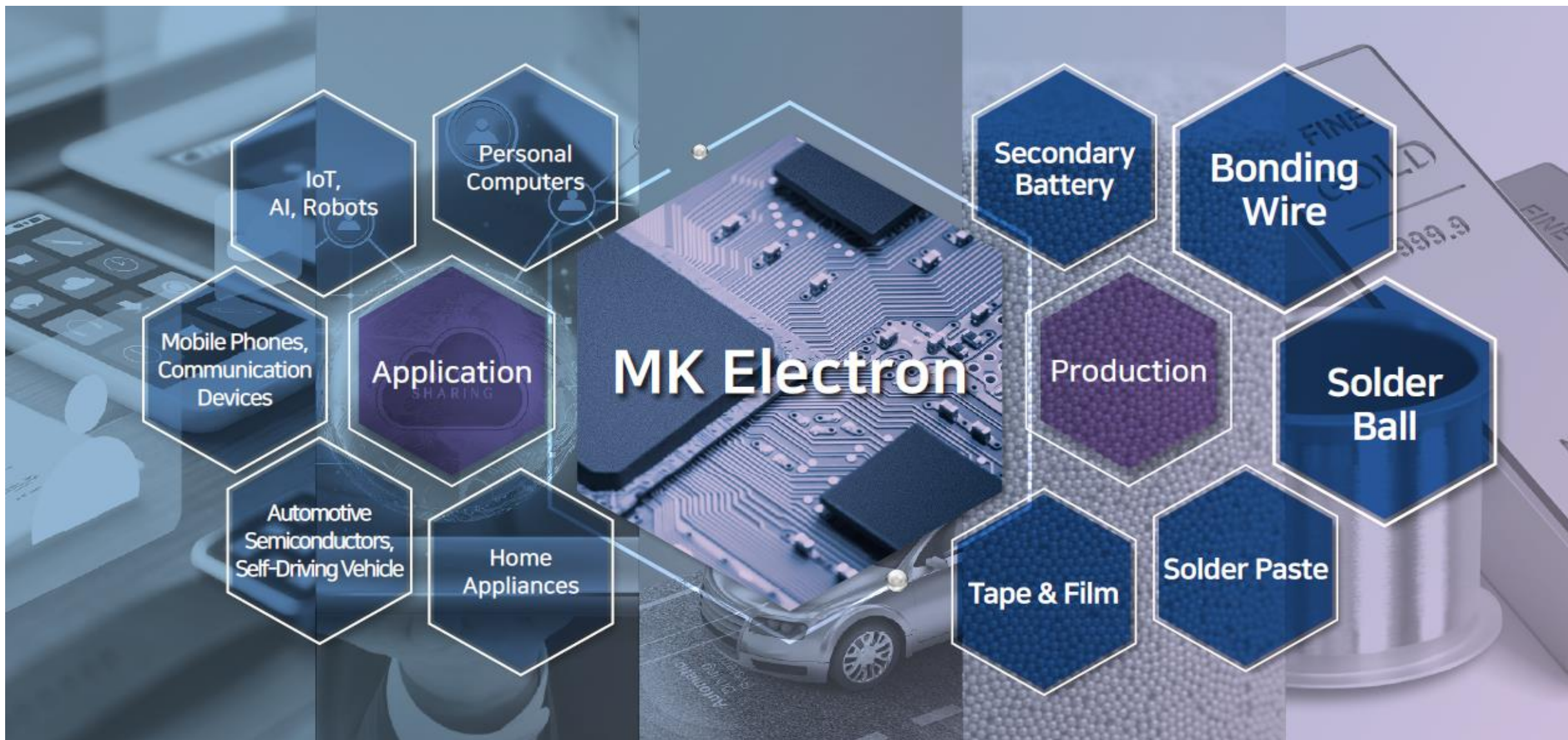
1997 코스닥 시장 등록

- 2001 솔더볼 사업 개시
- 2009 중국 쿤산 법인 설립
- 2011 용인 신사옥 준공
(지하2층, 지상4층)
6억불 수출 탑 수상

확장기

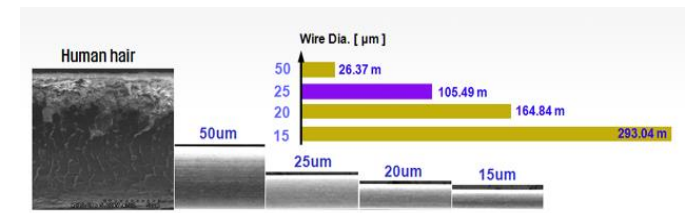
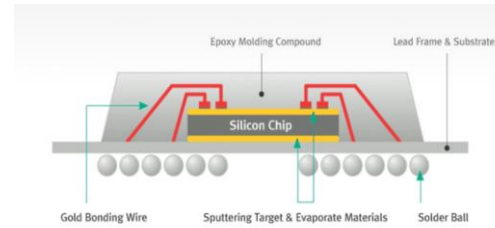
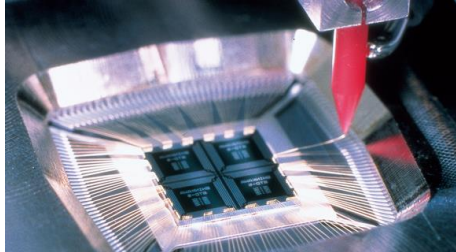
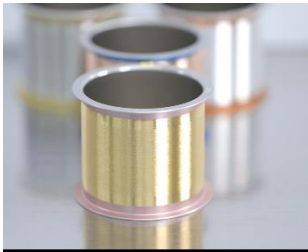
- 2015 한국토지신탁 종속회사 편입
- 2016 중국법인 Capa. 증설 신공장 준공(4월)
- 2016 중국법인 중국 장외시장 '신삼판' 상장(12월)
- 2018 충북 음성 원남 산업단지 공장 신축





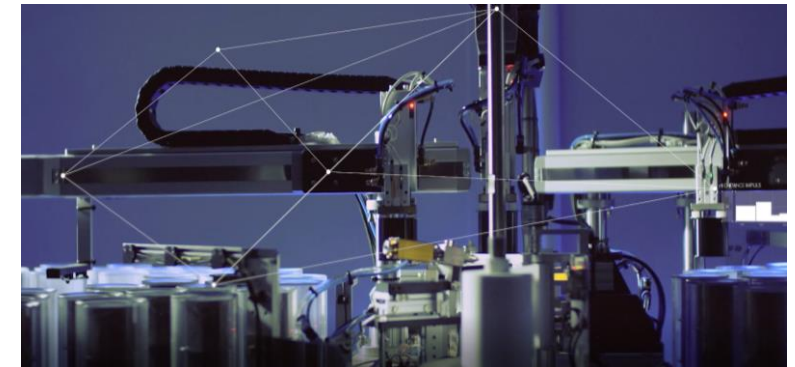
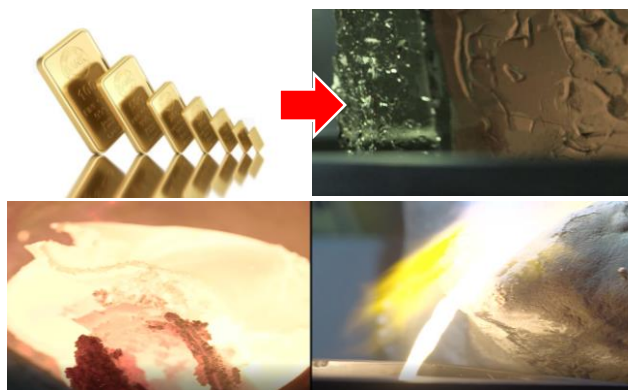
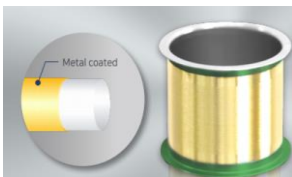
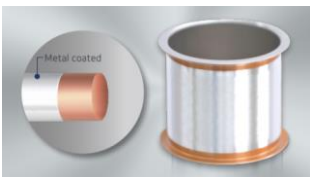
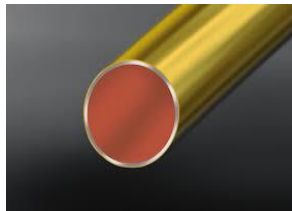
본딩와이어란?

- 반도체 조립 공정의 핵심 소재로 실리콘 칩과 리드를 연결하여 전기적 신호를 전달하는 부품
- 머리카락 굵기의 1/4 정도 되는 초 미세선으로 고온 접합 신뢰성과 기계적, 전기적 특성을 만족할 수 있는 기술력이 핵심
- 반도체의 경박단소화로 chip이 집적됨에 따라 반도체 조립 공정에 사용되는 wire 직경은 미세화 되는 추세



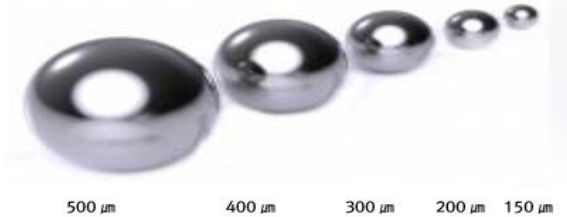
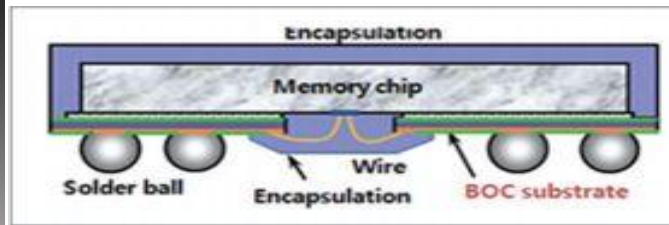
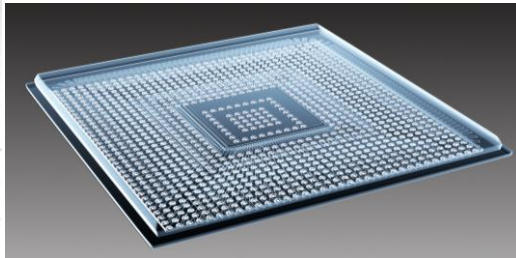
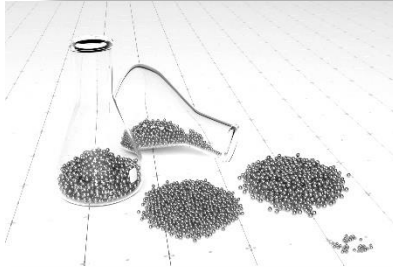
MKE 본딩와이어 경쟁력

- 도금 기술력 활용 도금 와이어 양산 및 판매
- 국내 최고 귀금속 정제 기술 보유(99.999%)
- Smart Factory 및 공정 자동화 시스템 구축 (생산성 ▲ 인력 ▼)

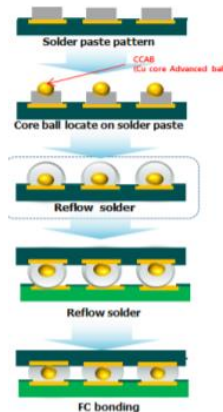
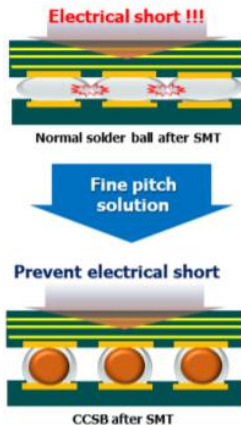
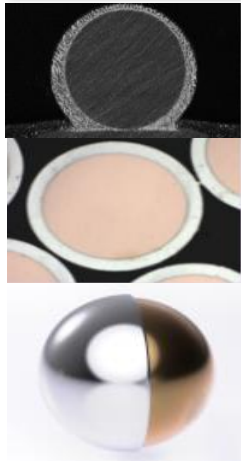


솔더볼이란?

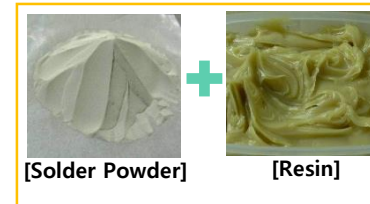
- 고집적 패키징 기술인 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package), WLCSP(Wafer level CSP)등의 반도체 칩을 PCB기판에 접착하는데 사용되는 초미세볼
- 조성에 따라 사용 온도가 180~220°C까지 다양하며 전기적, 기계적 특성이 핵심
- Sn(주석)+Pb(납)이 주요 원재료로 사용되었으나 환경규제에 따라 Pb 함량이 0.1% 이하인 Lead(Pb)-Free 조성개발, 판매중



CCSB(Copper Core Solder Ball) , CCAB(Copper Core Advanced Ball), Solder Paste



- 적층 형태의 반도체 증가에 따른 PKG 제조 공정간 층간 뒤틀림으로 인한 쇼트 발생
→ 신규 제품 개발 CCSB, CCAB개발
20년 2Q~ 판매 진행중
→ 高 마진률

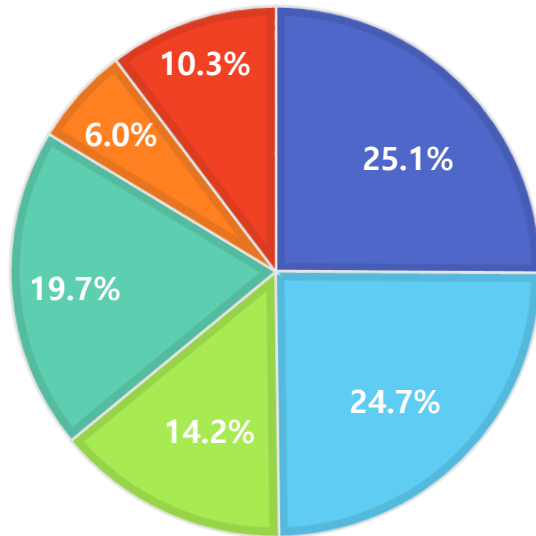


- 파우더 : 5 ~ 40um 크기에 솔더 분말 제작(MKE)
- 레진 : 협력사를 통한 OEM 운용 → 향후 내재화
- 반도체용 제품 판매중
→ 자동차, 가전 분야 확대

Company Overview

Market Share ('20년 1H기준)

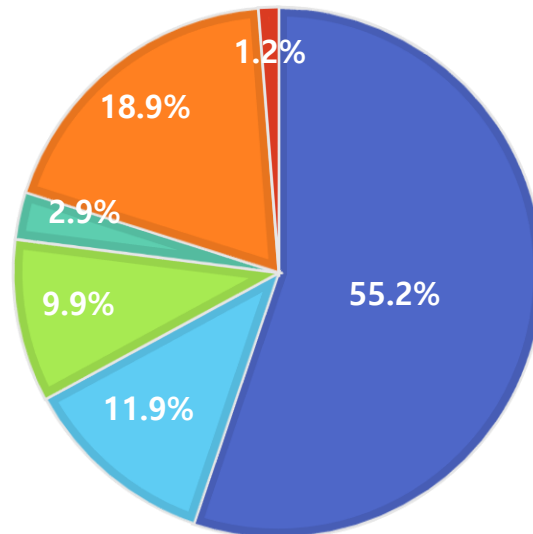
■ MKE ■ A ■ B ■ C ■ D ■ others



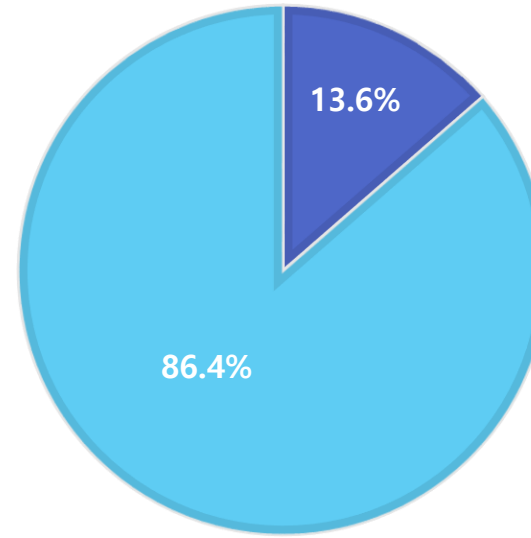
- 세계 시장 점유율 **25.1%** 1위
- 국내외 시장 영향력 강화

Korea Bonding Wire

■ MKE ■ A ■ B ■ C ■ D ■ others



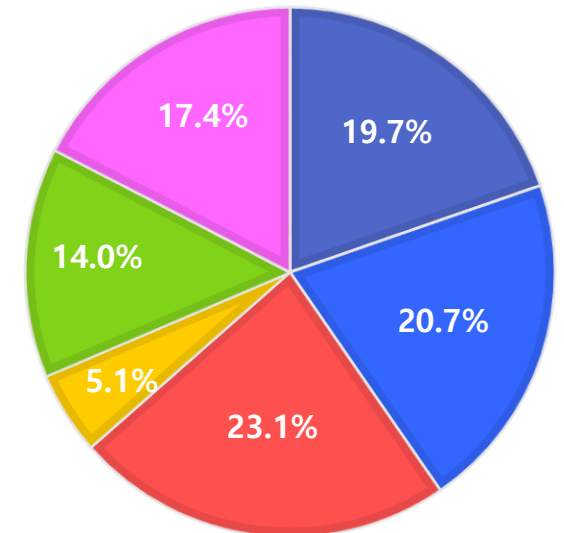
■ MKE ■ others

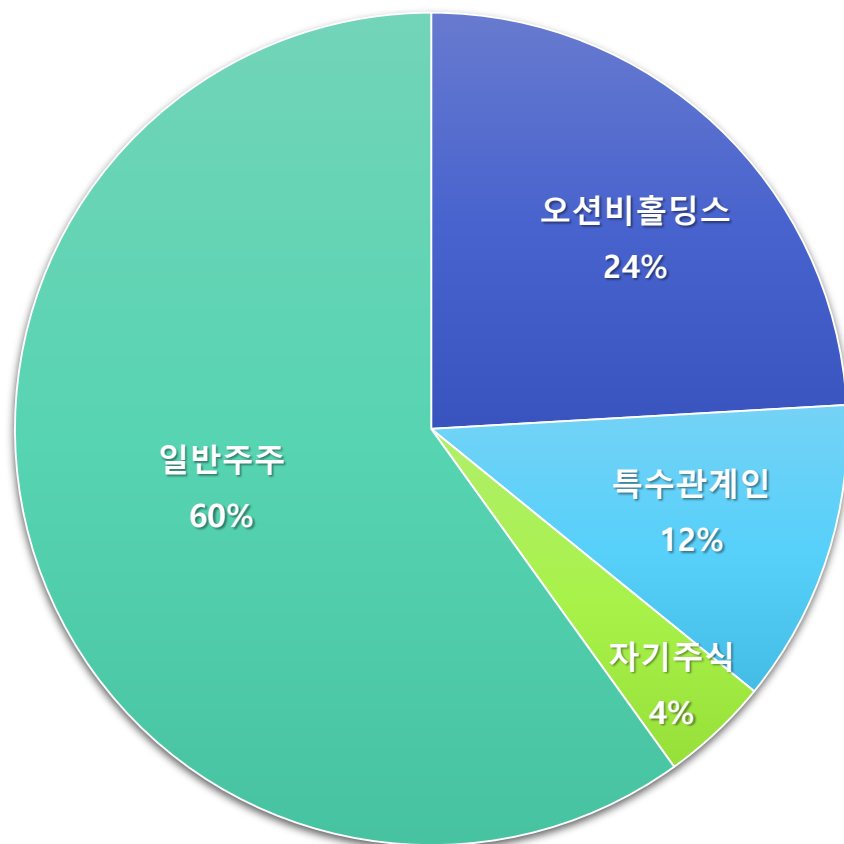


- 세계 시장 점유율 **13.6%** 3위
- 신제품 개발을 통한 경쟁 동력 확보 (CCSB, CCAB)

Korea Solder Ball

■ MKE ■ A ■ B ■ C ■ D ■ others





■ 오션비홀딩스 ■ 특수관계인 ■ 자기주식 ■ 기타

구분	주식수	지분율
오션비홀딩스(주)	5,251,800	24.08%
특수관계인 / 차정훈 회장	2,566,245	11.77%
일반주주	13,070,390	59.93%
자기주식	919,254	4.22%
합계	21,807,689	100%

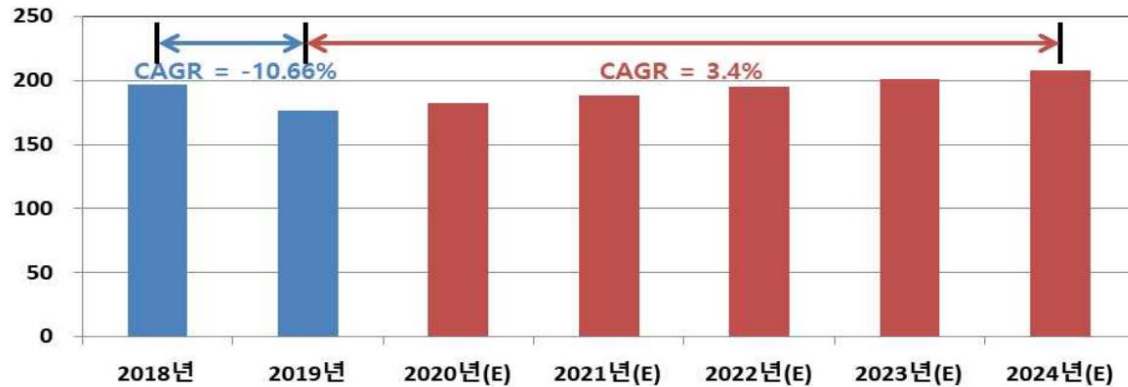
- 140개 이상의 글로벌 반도체 업체들과의 거래중이며, 매출 중 해외 판매 비중이 95%



Company Overview

20년도 실적(E) 및 21년도 전망

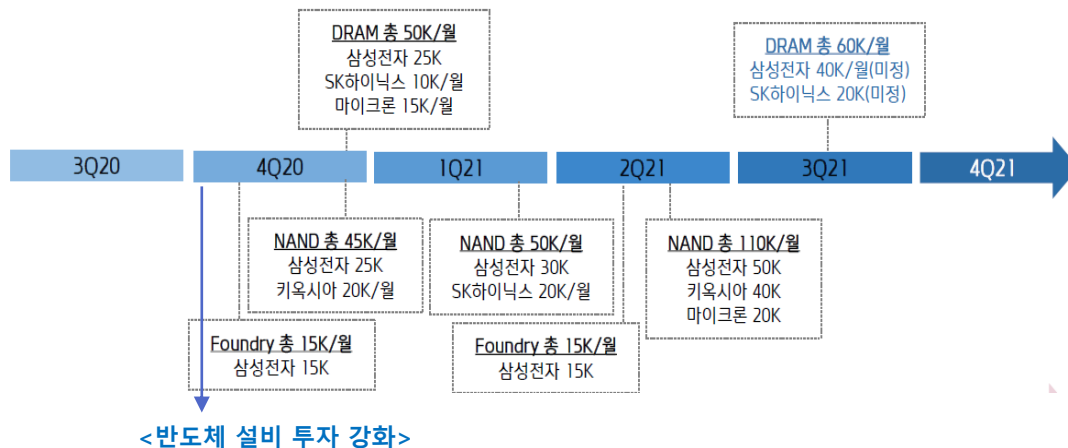
시장의 성장과 엠케이전자의 브랜드 강화



*출처: Global Semiconductor Packaging Materials Outlook(2020 to 2024), SEMI & TechSearch(2020),

- 시장 분석 업체인 SEMI, 테크서치 를 중심으로 반도체 패키징 재료 시장에 대한 지속 성장 예상 (연 3.4% 성장)
- 코로나19로 인한 불확실성 속에서 안정적인 공급을 통한 고객사의 신뢰도 강화

반도체 전방산업의 투자 강화(설비 투자에 따른 소재 수요 증가 시점 도래)



- 20년도 4Q 부터 IDM/OSAT 관련 설비업체의 투자 증대
 - 통신, 모바일, 서버 등 반도체 수요 강세
 - 전방산업의 설비 투자에 따른 반도체 소재 수요 증가
- * 21년도 1Q 계획 대비 상회하는 물량 증가 예상



MK Electron Co., Ltd.

Thank You